

HDI基板対応 ALPHO® LIP3100シリーズ

For HDI manufacturing process ALPHO® LIP3100 series (under R&D)

For
DI / LDI

特長 Features

- HDI回路形成に適したドライフィルムフォトレジストです。高感度、高解像、高い追従性により歩留まりと生産性に貢献します。
- Dry Film Photo Resist suitable for HDI manufacturing process. Contribute to high yield ratio and productivity by its high photosensitivity, high resolution and high conformance to base materials.

使用例 Applications

- HDI基板、高多層基板テンティング/エッチング
HDI, MLB Tenting/Etching
- 各種ダイレクトイメージング露光機対応 (i-線/h-線)
Various Direct Imaging (i-Line/h-Line) Exposure System

レジスト特性 Resist performance

Dry film	LIP3125	LIP3130	LIP3140
レジスト厚 Resist Thickness (μm)	25	30	40
露光量※2 Exposure Energy (mJ/cm ²)	25	25	35
解像密着性 Resolution and Adhesion L/S=x/x (μm)	20	25	25
細線密着性 Adhesion L/S=x/9x (μm)	20	22	25

※1 現像条件 (Developing condition) : 1.0%Na₂CO₃, 30°C, BP x 2

※2 DI露光 (Direct imaging exposure) : h-line DI Machine

